

## PCB加工工艺要求说明

## 1. 一般信息

1.0 主要技术联系人: 买买提 电话: 18875288184

邮箱: 传真:

1.1 其他技术联系人: kangming.dai@hampoo.com

注意: EQ确认单问请抄送上述所有邮箱, 如一定时间内未回复, 请电话联系“主要技术联系人”, 以保证第一时间确认工程问题, 谢谢!

## 2. 工艺信息

2.0 板名: 13kW\_HVAC\_Control\_Board\_P2 特殊板种类: 一般通孔板

2.1 层数: 4层 最小孔径(mm): 0.2032

2.2 基材: FR4 孔密度(个/平方米): 162283.52

2.3 厚径比: 8:1 最小线宽/距(mil): 6.00/5.00

翘曲度:  $\leq 0.75\%$ 

2.4 单板(Unit)尺寸(mm): 73.03 X 46.99 拼板方式: 2 X 5

拼板(Set)尺寸(mm): 162.05 X 192.79 每拼板(Set)单板(Unit)数: 10 组成拼板的单板种数: 1

☐ V-CUT:2.5 板厚(mm): 1.6 公差:  $\pm 10\%$ 

2.6 阻焊: 双面印 颜色: 绿色 阻焊光面: 亮光

2.7 字符: 双面印 颜色: 白色

标记: ☐ UL

请不要在板内空白区域添加制板厂logo.

请在板内空白区域添加板子生产日期.

2.8 表面处理: 沉金 金厚:  $\geq 0.05\mu\text{m}$  镀金手指: ☒ 无 ☐ 有, 金厚:金手指斜边: ☐ Yes ☒ No板厚削薄边: ☐ Yes ☒ No2.9 过孔阻焊处理方式: ☐ 除焊盘区域外整板塞孔 ☐ BGA区域塞孔, 其他按Gerber☒ 整板过孔塞孔 ☐ 全部按Gerber 塞孔物质: 油墨2.10 阻抗控制: ☐ Yes ☒ No2.11 盲孔/HDI: ☐ Yes ☒ No2.12 验收标准或规范: ☒ IPC-6012-II, current revision.2.13 IPC网表对比: ☒ Yes ☐ No2.14 交货附件: ☒ 电测报告 ☒ 出货检测报告 ☒ Gerber☒ PCB切片报告(最小直径过孔及内/外层线路位置) ☐ 阻抗测试报告☐ 其他2.15 包装要求: ☒ 真空包装, ☒ 板间隔纸

3. 叠层设置

